

海通证券股份有限公司关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司

2024 年半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：海通证券股份有限公司	被保荐公司简称：芯碁微装
保荐代表人姓名：林剑辉、周磊	被保荐公司代码：688630

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥芯碁微电子装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]350 号）核准，合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票 3,020.24 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 15.23 元，募集资金总额为人民币 45,998.33 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 41,635.82 万元。本次发行证券已于 2021 年 4 月 1 日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 4 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥芯碁微电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]563 号）批复，公司向特定对象发行股票 1,049.7245 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 75.99 元，募集资金总额为人民币 79,768.56 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 78,936.29 万元。本次发行证券已于 2023 年 8 月 4 日在上海证券交易所上市。海通证券担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2023 年 8 月 4 日至 2025 年 12 月 31 日。

在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日持续督导期内（以下简称“本持续督导期间”），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，现就 2024 年半年度持续督导情况报告如下：

一、2024年上半年保荐机构持续督导工作情况

项目	工作内容
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，针对公司的具体情况确定持续督导的内容和重点，督导公司履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所或其他机构提交的其他文件，并按保荐办法要求承担相关持续督导工作。	保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度，针对公司的具体情况确定持续督导的内容和重点，督导公司履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所或其他机构提交的其他文件，并按保荐办法要求承担相关持续督导工作。
2、根据上市规则规定，与公司就持续督导期间的权利义务签订持续督导协议。	保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务。
3、协助和督促上市公司建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，以符合法律法规和上市规则的要求，并确保上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员、核心技术人员知晓其在上市规则下的各项义务。	保荐机构已协助和督促上市公司建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，以符合法律法规和上市规则的要求，并确保上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员、核心技术人员知晓其在上市规则下的各项义务。
4、持续督促上市公司充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。	保荐机构已持续督促上市公司充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
5、对上市公司制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助，确保其信息披露内容简明易懂，语言浅白平实，具有可理解性。	保荐机构已对上市公司制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助，确保其信息披露内容简明易懂，语言浅白平实，具有可理解性。
6、督促上市公司控股股东、实际控制人履行信息披露义务，告知并督促其不得要求或者协助上市公司隐瞒重要信息。	保荐机构已督促上市公司控股股东、实际控制人履行信息披露义务，告知并督促其不得要求或者协助上市公司隐瞒重要信息。
<p>7、上市公司或其控股股东、实际控制人作出承诺的，保荐机构、保荐代表人应当督促其对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。</p> <p>保荐机构、保荐代表人应当针对前款规定的承诺披露事项，持续跟进相关主体履行承诺的进展情况，督促相关主体及时、充分履行承诺。</p> <p>上市公司或其控股股东、实际控制人披露、履行或者变更承诺事项，不符合法律法规、上市规则以及上海证券交易所其他规定的，保荐机构和保荐代表人应当及时提出督导意见，并督促相关主体进行补正。</p>	<p>本持续督导期间，上市公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况。</p> <p>上市公司或其控股股东、实际控制人已对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。</p>
8、督促上市公司积极回报投资者，建立健全	保荐机构已督促上市公司积极回报投资者，建

项 目	工作内容
并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。	立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。
9、持续关注上市公司运作，对上市公司及其业务有充分了解；通过日常沟通、定期回访、调阅资料、列席股东大会等方式，关注上市公司日常经营和股票交易情况，有效识别并督促上市公司披露重大风险或者重大负面事项，核实上市公司重大风险披露是否真实、准确、完整。	保荐机构已持续关注上市公司运作，对上市公司及其业务有充分了解；通过日常沟通、定期回访、调阅资料、列席股东大会等方式，关注上市公司日常经营和股票交易情况。本持续督导期间，上市公司不存在应披露而未披露的重大风险或者重大负面事项。
10、重点关注上市公司是否存在如下事项： （一）存在重大财务造假嫌疑； （二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益； （三）可能存在重大违规担保； （四）资金往来或者现金流存在重大异常； （五）上交所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。 出现上述情形的，保荐机构及其保荐代表人应当应当自知道或者应当知道之日起 15 日内按规定进行专项现场核查，并在现场核查结束后 15 个工作日内披露现场核查报告。	本持续督导期内，上市公司未出现该等事项。
11、关注上市公司股票交易严重异常波动情况，督促上市公司及时按照上市规则履行信息披露义务。	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。
12、上市公司日常经营出现下列情形的，保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对公司经营的影响以及是否存在其他未披露重大风险发表意见并披露： （一）主要业务停滞或出现可能导致主要业务停滞的重大风险事件； （二）资产被查封、扣押或冻结； （三）未能清偿到期债务； （四）实际控制人、董事长、总经理、财务负责人或核心技术人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施； （五）涉及关联交易、为他人提供担保等重大事项； （六）本所或者保荐机构认为应当发表意见的其他情形。	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。
13、上市公司业务和技术出现下列情形的，保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对公司核心竞争力和日常经营的影响，以及是否存在其	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。

项 目	工作内容
<p>他未披露重大风险发表意见并披露：</p> <p>（一）主要原材料供应或者产品销售出现重大不利变化；</p> <p>（二）核心技术人员离职；</p> <p>（三）核心知识产权、特许经营权或者核心技术许可丧失、不能续期或者出现重大纠纷；</p> <p>（四）主要产品研发失败；</p> <p>（五）核心竞争力丧失竞争优势或者市场出现具有明显优势的竞争者；</p> <p>（六）本所或者保荐机构认为应当发表意见的其他情形。</p>	
<p>14、控股股东、实际控制人及其一致行动人出现下列情形的，保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对上市公司控制权稳定和日常经营的影响、是否存在侵害上市公司利益的情形以及其他未披露重大风险发表意见并披露：</p> <p>（一）所持上市公司股份被司法冻结；</p> <p>（二）质押上市公司股份比例超过所持股份80%或者被强制平仓的；</p> <p>（三）上交所或者保荐机构认为应当发表意见的其他情形。</p>	<p>本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。</p>
<p>15、督促控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺，关注前述主体减持公司股份是否合规、对上市公司的影响等情况。</p>	<p>保荐机构已督促控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺，持续关注前述主体减持公司股份是否合规、对上市公司的影响等情况。</p>
<p>16、持续关注上市公司建立募集资金专户存储制度与执行情况、募集资金使用情况、投资项目的实施等承诺事项，对募集资金存放与使用情况进行现场检查。</p>	<p>保荐机构对上市公司募集资金的专户存储、募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注，督导公司执行募集资金专户存储制度及募集资金监管协议，于2024年8月5日至2024年8月6日对上市公司募集资金存放与使用情况进行了现场检查。</p>
<p>17、保荐机构发表核查意见情况。</p>	<p>2024年上半年，保荐机构发表核查意见具体情况如下：</p> <p>2024年1月27日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司向特定对象发行限售股上市流通的核查意见》；</p> <p>2024年3月23日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》；</p> <p>2024年4月24日，保荐机构发表《海通证券</p>

项 目	工作内容
	股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》； 2024年4月24日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》； 2024年5月29日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司差异化分红送转特殊除权除息事项的核查意见》。
18、保荐机构发现的问题及整改情况（如有）	无

二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

海通证券持续督导人员对上市公司本持续督导期间的信息披露文件进行了事先或事后审阅，包括股东大会会议决议及公告、董事会会议决议及公告、监事会会议决议及公告、募集资金使用和管理的相关报告和其他临时公告等文件，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

经核查，保荐机构认为，上市公司严格按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、重大风险事项

公司面临的风险因素主要如下：

（一）核心竞争力风险

公司属于技术密集型行业，升级换代速度快，较强的技术研发实力是行业内公司保持持续竞争力的关键要素之一。为了保持技术领先优势和持续竞争力，公司必须准确地响应客户需求并预测技术发展方向，并根据预测进行包括对现有技术进行升级换代在内的研发投入。若公司未来不能准确把握相关产品技术和市场发展趋势，技术升级迭代进度和成果未达预期，或者新技术无法实现产业化，将影响公司产品的竞争力并错失市场发展机会，对公司的持续竞争能力和未来业务发展产生不利影响。

（二）市场竞争加剧风险

目前国内 PCB 直接成像设备及泛半导体直写光刻设备市场主要由欧美、日本等国家和地区的国际知名企业所占据。近年来随着我国对相关产业的高度重视和支持力度加大，我国 PCB 及泛半导体设备行业技术水平不断提高，国产设备在产品性价比、售后服务等方面的优势逐渐显现。我国 PCB 及泛半导体设备厂商的逐步崛起，将会引起国际竞争对手的重视，从而加剧市场竞争。此外，PCB 及泛半导体设备市场需求的快速增长以及国内巨大的进口替代市场空间，还将吸引更多的潜在进入者。因此，公司面临市场竞争加剧的风险。

（三）行业风险

公司所处行业受下游 PCB 及泛半导体终端消费市场需求波动的影响，其发展往往呈现一定的周期性，若上述终端行业的产品高端化升级趋势放缓或遭遇周期性全球宏观经济环境恶化，将直接影响上述终端行业产品的市场需求，从而对上游 PCB、泛半导体光刻设备的市场需求造成不利影响，存在一定的周期性波动风险。

（四）宏观环境风险

近年来，国际贸易环境日趋复杂，在 PCB、泛半导体等高科技产业中影响较大，在带来相关产业国产替代机遇的同时也存在一定的风险。目前全球通胀处于较高水平，若无有效政策加以限制，国际争端等如继续恶化，对公司全球市场的布局以及部分原材料的采购会产生一定影响。

四、重大违规事项

2024 年上半年，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

报告期内，公司主要财务数据如下：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减
--------	----------------	------	-----------------

			(%)
营业收入	449,434,289.81	318,659,921.78	41.04
归属于上市公司股东的净利润	100,694,227.54	72,674,167.70	38.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,529,823.36	67,561,124.68	45.84
经营活动产生的现金流量净额	-47,434,123.78	-108,957,412.69	56.47
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,001,044,530.46	2,031,690,393.13	-1.51
总资产	2,586,711,723.30	2,480,473,001.97	4.28

报告期内，公司主要财务指标如下：

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.77	0.60	28.33
稀释每股收益(元/股)	0.77	0.60	28.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.75	0.56	33.93
加权平均净资产收益率(%)	4.84	6.68	减少 1.84 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.73	6.21	减少 1.48 个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	10.89	12.19	减少 1.30 个百分点

报告期内，公司实现营业收入 44,943.43 万元，同比增长 41.04%，归属于上市公司股东的净利润 10,069.42 万元，同比增长 38.56%，报告期内，受益于 PCB 市场中高端化趋势，公司不断提升 PCB 线路和阻焊层曝光领域的技术水平，在最小线宽、产能、对位精度等设备核心性能指标方面具有较高的技术水平，全面推动公司产品体系的高端化升级，凭借产品稳定性、可靠性、性价比及本土服务优势，使得产品市场渗透率快速增长。

公司经营活动产生的现金流量净额-4,743.41 万元，同比增长 56.47%，主要系销售回款同比增加所致。

六、核心竞争力的变化情况

(一) 技术与创新优势

技术创新是公司保持竞争优势的关键。首先，公司在研发方面持续投入，报告期内研发投入持续增加，研发费用的持续投入为公司形成体系化的技术升级能力和打造不断深化的技术创新优势提供了重要保障。

其次，在技术成果方面，持续的研发投入也为公司积累了大量技术成果，截至 2024 年上半年，公司累计获得知识产权 233 项，其中发明专利 70 项，实用新型专利 109 项，外观专利 8 项，软件著作权 46 项。通过持续的自主研发，公司已形成了系统集成技术、光刻紫外光学及光源技术、高精度高速实时自动对焦技术、高精度高速对准多层套刻技术、高精度多轴高速大行程精密驱动控制技术、高可靠高稳定性的 ECC 技术、高速实时高精度图形处理技术等一系列直写光刻关键技术。

最后，在技术成果转化方面，报告期内，公司通过市场、客户与产业融合，开发了一系列新产品。首先，持续进行研发投入对产品进行更新换代，推动产品升级朝着更精细的光刻精度发展；其次，着眼客户需求，开发了高效、高稳定性、小型化设备；最后，提前布局相关产品，紧跟产业发展步伐，从研发和扩产两个维度推进 PCB 设备的产品升级，同步加大高端阻焊市场的 NEX 系列直写光刻设备的扩产，不断拓展 FPD 制造、IC 后道封装、OLED、新型显示、掩膜版制版和新能源光伏等应用领域。在公司与客户、产业的融合中，进一步巩固和提升了公司的核心技术优势。部分产品相关技术指标比肩或超过国际厂商，具有较强的产品竞争力。

（二）市场和客户资源优势

公司凭借具有较强竞争力的产品及优秀的销售团队不断开拓下游市场，建立了完善的销售、技术和服务网络，在 PCB 及泛半导体领域内积累了丰富的客户资源。

在 PCB 领域，公司直接成像设备销售收入逐年增长，市场占有率不断提升，积累了大量全球高质量客户，实现了 PCB 百强全覆盖。报告期内，公司深化了与深南电路、生益电子、胜宏科技、定颖电子、沪电股份、红板公司等客户的合作，国际头部厂商鹏鼎控股订单表现良好，软板、类载板、防焊等细分市场表现优异。

泛半导体领域，公司产品应用在 IC、MEMS、生物芯片、分立功率器件等制造、IC 掩模版制造、先进封装、显示光刻等环节，应用场景不断拓展，积累了华天科技、绍兴长电、维信诺、辰显光电、佛智芯、矽迈微、华芯中源、泽丰半导体等企业级客户；IC 载板领域拓展了兴森科技、浩远电子、明阳电路、柏承微电子、英创力等公司。

综上，公司产品凭借良好的技术、本地化服务优势取得了各大客户的认可，与各大客户建立了长期、稳定的合作伙伴关系，具有较高的客户粘性。优质的市场客户资源对公司的技术创新、市场占有率、品牌影响力和盈利水平等具有重大影响，为公司后续业务的持续拓展奠定了坚实的基础。

（三）快速服务、响应优势

直写光刻设备是 PCB、泛半导体领域制造工艺中的核心设备之一，下游厂商对设备的质量、性能及稳定性要求较高，并对设备的调试、维保等服务要求较高。公司拥有专业技术服务团队，分布在我国 PCB、泛半导体等电子信息产业集中的华南、华东、华中、华北和台湾等区域，相比德国 Heidelberg、以色列 Orbotech、日本 ORC 等国外竞争厂商，公司凭借本土服务优势，能够为国内客户提供更为迅速、及时的 7*24 小时技术支持与服务，做到 30 分钟响应、国内 2 小时到达现场，形成了快速服务及响应的竞争优势。

国际化方面，公司积极建设海外销售及运维团队，加速海外市场拓展，已有设备成功销往泰国、越南、日本、韩国和澳洲等区域，业务增势迅猛，出口订单表现良好。报告期内，公司加大了东南亚地区的市场布局，积极建设海外销售及运维团队，发挥自身品牌、技术开发和市场营销的优势，增强海外客户的服务能力。

（四）产品应用场景优势

与国内厂商相比较，公司直写光刻设备覆盖了 PCB 制造、IC/MEMS/生物芯片/分立功率器件等制造、IC 掩模版制造、先进封装、显示光刻、新能源光伏等多个细分应用领域，在直写光刻领域具有较为丰富的产品布局，能够覆盖更为广阔的下游细分市场，满足细分领域内客户的差异化需求，从而形成一定的产品应

用场景优势。未来，随着公司技术的不断升级，产品将持续向泛半导体细分领域拓展，进一步增强公司产品应用场景优势。

（五）专业团队优势

高素质、经验丰富的技术团队是公司保持技术创新的根本保障。公司始终重视技术人才队伍的建设和培养，通过内部培养和外部引进的方式形成了深厚的人才储备。公司领军人才先后获得“安徽省高层次科技人才团队”、“安徽省创新创业领军人才”、“安徽省百人计划引进人才”、“庐州产业创新团队”、“江淮硅谷创新创业团队”、“合肥市领军人才”、安徽省“专精特新”企业 50 强等荣誉称号。公司科学家团队具备三十年以上半导体设备开发经验，来自于蔡司、科天半导体、球半导体等国际厂商。截至 2024 年上半年，公司研发技术团队共有 214 人，占员工总人数的 34.80%。研发人员专业覆盖面广，涵盖光学、精密机械、图形处理、机器视觉、深度学习、测控技术与仪器等专业领域。

（六）差异化竞争策略优势

近年，面对复杂的外部环境和激烈的市场竞争，公司差异化竞争优势明显。在 PCB 高阶市场，公司可直接对标国际竞争对手，以产品稳定性、可靠性及本地化服务优势攻占高端市场；在 PCB 中低阶市场，公司 FAST 系列产品以性价比、可靠性、稳定性优势抢占低端市场，提升市场占有率；在泛半导体领域，公司拥有泛半导体事业部，全力支撑泛半导体产品线发展，持续进行产品研发创新，全面拓展应用领域，满足境内外客户对高性能直写光刻设备的需求，积极融入全球化的竞争格局，力争成为微纳直写光刻领域的国际领先企业。

七、研发支出变化及研发进展

单位：元

	本期数	上年同期数	变化幅度（%）
费用化研发投入	48,934,569.54	38,851,978.27	25.95
资本化研发投入	0	0	0
研发投入合计	48,934,569.54	38,851,978.27	25.95
研发投入总额占营业收入比例（%）	10.89	12.19	减少 1.30 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	0	0	0

报告期内，公司新增获得 21 项研发成果，其中发明专利 5 项，实用新型专利 13 项，外观设计专利 1 项，软件著作权 2 项。

报告期内获得的知识产权情况如下：

	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	14	5	201	70
实用新型专利	15	13	134	109
外观设计专利	1	1	10	8
软件著作权	0	2	46	46
其他	0	0	0	0
合计	30	21	391	233

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

九、募集资金的使用情况是否合规

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 15 日出具的《关于同意合肥芯碁微电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]563 号），同意公司向特定对象发行股票注册申请。公司向特定对象发行 10,497,245 股人民币普通股，募集资金总额为人民币 797,685,647.55 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 8,322,726.38 元，募集资金净额为人民币 789,362,921.17 元。上述资金已于 2023 年 7 月 25 日全部到位，并存放于公司开设的募集资金专项账户内。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具《合肥芯碁微电子装备股份有限公司验资报告》（容诚验字[2023]230Z0198 号）。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放银行产生利息扣除手续费后的净额为 5,048,616.93（含活期利息）元。截至 2024 年 6 月 30 日，已使用募集资金金额为人民币 210,523,966.96 元，本年度已使用募集资金金额为人民币 134,237,611.36 元，进行现金管理余额为人民币 570,000,000 元，募集资金存储账户余额为人民币 13,887,571.14 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下表所示：

开户银行	账号	存款方式	2024 年 6 月 30 日账户余额 (人民币元)
招商银行合肥分行营业部	551906776410802	活期余额	7,803,629.47
徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	522001541721000002	活期余额	1,461,724.28
中信银行股份有限公司合肥分行营业部	8112301012100947766	活期余额	1,387,884.03
中国光大银行合肥长江西路支行	76670180803908811	活期余额	3,234,333.36
合计	/	/	13,887,571.14

公司 2024 年上半年募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金管理和使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

2024 年上半年，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化，不存在质押、冻结或减持情况。

十一、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告或应当发表意见的其他事项

经核查，截至本持续督导跟踪报告出具之日，上市公司不存在按照《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告或应当发表意见的其他事项。

十二、其他说明

本报告不构成对上市公司的任何投资建议，保荐机构提醒投资者认真阅读上市公司审计报告、年度报告等信息披露文件。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《海通证券股份有限公司关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名:


林剑辉


周磊

